



特許出願中

BGA

CSP

MCM

Balling

Re-Balling

簡易ボール搭載器 BM-11series

BM-11はBGA,CSPやMCMに端子のボールはんだを、簡単に搭載するジグです。初めての人でも簡単にRe-Ballingができます。今まで難しかった、Cavity-Downや高温ボールはんだの搭載も簡単にできます。そして、**価格は従来装置の十分の一以下です。**

特長

- BGA,CSPやMCM各々のパッケージに合わせた、専用のホルダーとスクリーンを用いて、誰でも簡単にボールはんだの搭載ができます。**操作は簡単、価格は従来装置の十分の一以下。**
- 従来の方法では難しかった、Cavity-Downのパッケージや高温(290℃)のボールはんだ搭載 / 生成も、簡単にできます。
- 煩わしいフラックスやクリームはんだの印刷や、スクリーンの位置合わせが必要ありません。
 1. パッケージ端子側全面に、エアゾール式のフラックスをスプレーします。
 2. そのパッケージをホルダーにセットし、上にボール搭載用スクリーンを乗せれば、ごく簡単に位置合わせ完了。
 3. ボールはんだをスクリーン上に端子数より多めに供給し、ホルダーごと数回振ってボールを穴に落下させる。
 4. スクリーンの後端を押し下げ、前端を少し上げて残ったボールごとスクリーンを持ち上げれば、ボール搭載完了。
 5. ホルダーごとパッケージをリフロー装置に入れて、はんだ付けすればボール生成(Re-Balling)完成です。

仕様

- ・ホルダー
 - ・材質 : アルミ, マグネシウム
 - ・寸法 : 50×50mm, 60×60mm, 70×70mm, 80×80mm
 - ・厚さ : 2mm, 3mm
 - ・重量 : 2～10g
- ・スクリーン(μ S-100series)
 - ・材質 : SUS304
セラミックス / 耐熱樹脂(高温はんだ用)
 - ・寸法 : 40×40mm～70×70mm(4種類)

対応パッケージ

- ・サイズ : 6×6mm～50×50mm
- ・ピン数 : 30pin～3000pin
- ・ピッチ : 1.5mm～0.8mm
- ・ボール径 : 0.89mmφ～0.4mmφ
- ・ボールはんだ : 183℃, 290℃

オプション

- ・フラックス エアゾール式レジ系無洗浄タイプ
- ・ボール・プレスサー 10×10×75mm

本仕様は予告なく変更することがあります。